



2023年12月13日

各 位

会 社 名 ウ シ オ 電 機 株 式 有 限 公 司
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 内 藤 宏 治
(コード番号 6925 東証プライム)
問 合 せ 先 経 理 財 務 部 長 瀧 澤 秀 明
(TEL. 03 - 5657 - 1000)

Applied Materials, Inc. との最先端半導体パッケージ市場向け次世代露光技術開発における
戦略的パートナーシップ締結のお知らせ

当社は、2023年11月13日付取締役会決議に基づき、下記のとおり、Applied Materials, Inc. (以下「AMAT社」又は「アプライド マテリアルズ」といいます。) との業務提携契約書を締結し、本日、AMAT社と同時に本合意のアナウンスをすることとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 業務提携の理由

AIの活用拡大による処理負荷の急増により、最先端半導体パッケージ基板市場において高機能で大型のチップへのニーズが高まり、半導体メーカーでは、最先端のパッケージに複数のチップレットを実装しパフォーマンス向上を目指す動きが広がっています。これに伴い、最先端半導体パッケージ基板向け露光装置についても、世界の大手半導体メーカーが目指すサブミクロン（線幅1ミクロン以下）での配線が求められるようになります。当社の20年以上のパッケージング向け露光装置の開発・製造実績と、AMAT社の新しいデジタルリソグラフィテクノロジー（DLT）を融合することで、これらの技術的課題を解決できるソリューションの提供が可能となります。この戦略的パートナーシップにより、最先端半導体パッケージ基板市場における露光装置のリーディングカンパニーとして、当社が保有する同市場領域での事業基盤を更に強固なものとし、中長期でのロードマップに沿った戦略を強化（製品ポートフォリオ拡大）することで、当社の中核事業である Industrial Process 事業の中長期での更なる成長拡大を目指してまいります。

2. 業務提携の内容等

今回の業務提携により、デジタルリソグラフィテクノロジーの先駆者である AMAT 社と共同で研究開発を行い、当社が長年培ってきた製造技術及び顧客基盤（サポート体制含む。）を活用することで、両社の強みを活かし、最先端半導体パッケージ基板市場向けにより付加価値の高いソリューションを提供することで、お客様が抱える先進的基板のロードマップ要件に応えることが可能となります。

3. 業務提携の相手先の概要

(1)	名 称	Applied Materials, Inc.		
(2)	所 在 地	3050 Bowers Avenue, Santa Clara, CA 95054, U.S.A.		
(3)	代表者の役職・氏名	Gary E. Dickerson, President and Chief Executive Officer		
(4)	事 業 内 容	半導体・ディスプレイ・関連業界向け製造装置とソフトウェアの開発、製造、販売及びサービス		
(5)	資 本 金 (2023年7月30日現在)	8,914 百万米ドル		
(6)	設 立 年 月 日	1967年11月10日		
(7)	大株主及び持株比率 (2023年9月30日現在)	The Vanguard Group 8.7% BlackRock Fund Advisors 5.4% State Street Global Advisors 4.4%		
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	該当事項はありません	
		人 的 関 係	該当事項はありません	
		取 引 関 係	当社子会社が当該会社グループに対して製品を供給しております。	
		関 連 当 事 者 への該当状 況	該当事項はありません	
(9)	当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
	決算期	2021年10月期 (監査済)	2022年10月期 (監査済)	2023年10月期 (未監査)
	純 資 産	12,247 百万米ドル	12,194 百万米ドル	16,349 百万米ドル
	総 資 産	25,825 百万米ドル	26,726 百万米ドル	30,729 百万米ドル
	売 上 高	23,063 百万米ドル	25,785 百万米ドル	26,517 百万米ドル
	営 業 利 益	6,889 百万米ドル	7,788 百万米ドル	7,654 百万米ドル
	当 期 純 利 益	5,888 百万米ドル	6,525 百万米ドル	6,856 百万米ドル
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益	6.40 米ドル	7.44 米ドル	8.11 米ドル
	1 株 当 たり 配 当 金	0.94 米ドル	1.02 米ドル	1.22 米ドル

4. 日 程

(1)	取締役会決議日	2023年11月13日
(2)	契約締結日	2023年11月13日
(3)	事業開始日	2023年12月1日

5. 今後の見通し

本件に伴う 2024 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、中長期的には当社グループの企業価値向上に資するものと考えております。今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

詳しくは、同日付で別途リリースした「ウシオとアプライド マテリアルズ、AI 時代のより強力なコンピューティングシステムを可能にする画期的デジタルリソグラフィ技術を発表」を参照ください。

以上